

新版・技能検定学科試験問題解説集NO.20 半導体製品製造
の解答について

● 162 ページ

【問18】 文中の [] に当てはまる語句の組合せとして、正しいものはどれか。

実装時に [A] 不良が、ユーザで発生することがある。その原因の一つに、ウェーハの [B] やチップのピックアップ時の [C] によるマイクロクラックの残留がある。

	A	B	C
イ	A1 腐食	バックグラインディング	コレット
ロ	A1 腐食	A1 エッチング	スクラブ
ハ	チップクラック	バックグラインディング	ノズル
ニ	チップクラック	バックグラインディング	突上げピン

解答と解説 ————— イ

《お詫び》

本設問の解答に誤りがございました。

謹んでお詫びするとともに、以下のように訂正いたします。

(誤) 解答と解説 ————— イ

(正) 解答と解説 ————— ニ